

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	开源证券、华安证券
会议时间	2024年3月5日14:00-16:00
会议地点	现场
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：董东峰 证券事务代表：钱云 证券事务专员：张雅婷
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请问LMC和GMC有什么区别？ 回复：LMC是指液态塑封材料，LMC是通过将液态树脂挤压到产品中央，在塑封机温度和压力的作用下增强液态树脂的流动性，从而填满整个晶圆。LMC具备可中低温固化、低翘曲、模塑过程无粉尘、低吸水率以及高可靠性等优点，是目前应用于晶圆级封装的相对成熟的塑封材料；GMC是指颗粒状环氧塑封材料，颗粒状环氧塑封料在塑封过程采用均匀撒粉的方式，在预热后变为液态，将带有芯片的承载板浸入到树脂中而成型，具有操作简单、工时较短、成本较低等优势。 问题二：请问当下公司高端环氧塑封料产品能够实现国产化替代吗？

	<p>回复：高端塑封料的技术突破到小批量出货到真正的批量需要相当长的时间，现阶段在高端塑封料领域外资仍处于主导地位，即便有部分高端塑封料实现了量产出货，但是进口替代仍然需要凭借不懈的技术开拓、稳定的产品质量、完善及时的客户服务逐步推进。</p> <p>问题三：请问公司是否有材料可以应用于 HBM 存储产业链？</p> <p>回复：公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）可以用于 HBM 的封装。相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。</p> <p>问题四：请问公司的材料是否应用光模块生产中？</p> <p>回复：光模块(optical module)是光纤通信系统的核心器件之一。其涉及的封装材料及封装形式较为多样。目前公司还没有与该领域的公司有直接业务往来。</p> <p>问题五：请问 QFN 和 DFN 的主要差别？</p> <p>回复：QFN，即方形扁平无引脚封装，表面贴装型封装之一，封装四侧配置有电极触点，由于无引脚，贴装占有面积比 QFP 小，高度比 QFP 低；DFN，即双边扁平无引脚封装，DFN 的设计和应用与 QFN 类似，都常见于需要高导热能力但只需要低引脚数的应用。DFN 和 QFN 的主要差异在于引脚只排列在产品下方的两侧而不是四周。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 5 日